

# 打线式贴片电阻

产品名称	打线式贴片电阻
公司名称	北京中企同和科技有限公司
价格	.00/颗
规格参数	
公司地址	北京市丰台区太平桥西里27号362室
联系电话	86-01056034197 15313872977

## 产品详情

可雷切芯片电阻(WB系列): 可 [单边或双边](#)  
打线 小型尺寸0201、0402、0603及其它特殊客制化尺寸，可依客户特殊规格需求订制。 精度：±0.1%，±0.5%，±1%，±5%，±10%, 低TCR 25ppm/℃，电阻值范围：1Ω~332KΩ 应用在LED定电流控制，小型化模块及混合电路(Hybrid Circuits)等等。

打线也叫Wire Bonding (压焊，也称为绑定，键合，丝焊)是指使用金属丝(金线、铝线等)，利用热压或超声能源，完成微电子器件中固态电路内部互连接线的连接，即芯片与电路或引线框架之间的连接。

产品规格说明PDF文件<http://viking.mhfs.cn/wb.asp>

### [产品特性：](#)

- 薄膜钝化镍铬电阻元件
- 公差为 ±0.1%
- 极低的温度系数 ±25PPM/°C
- 阻值范围宽
- 自定义的键合模式设计

### [产品参数：](#)

- 规格尺寸：0201、0402、0603；
- 阻值范围：10Ω~332KΩ（10ohm~332K ohm）；

精度： $\pm 0.1\%$ 、 $\pm 0.5\%$ 、 $\pm 1\%$ 、 $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$ ；

功率：1/16W、1/10W、1/8W、1/4W、1/3W、3/4W、1W；

温漂系数 (TCR)：25ppm、50ppm、100ppm；

使用温度范围： $-55^{\circ}\text{C}$  --  $+155^{\circ}\text{C}$ ；

工作电压：15V~50V；

(注：Viking能够按客户的要求制造需求的尺寸和阻值)

主要应用：

LED的恒流应用

医疗设备

测试/测量设备

混合芯片板电路

多芯片模块 (MCM) 封装

集成的MMIC

打线

打线也叫Wire Bonding (压焊，也称为绑定，键合，丝焊)是指使用金属丝(金线、铝线等)，利用热压或超声能源，完成微电子器件中固态电路内部互连接线的连接，即芯片与电路或引线框架之间的连接。

打线分类：

### 1、热超声/金丝球焊

该工艺利用加热温度和超声能量使被压紧在一起的两种金属界面间形成焊接键合。目前90%以上的半导体封装技术采用该工艺。

### 2、超声楔焊

利用超声能量作用于压紧在一起的两种金属间形成键合

### 3、热压焊

利用加热及压紧力形成键合。该技术1957年在贝尔实验室被使用，是最早的封装工艺技术，但现在已很少在用。